

(19) 대한민국특허청(KR)  
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>  
H01L 23/50

(11) 공개번호 특1997-0053778  
(43) 공개일자 1997년07월31일

(21) 출원번호	특1995-0068177
(22) 출원일자	1995년12월30일
(71) 출원인	삼성전자 주식회사 김광호
(72) 발명자	경기도 수원시 팔달구 매탄동 416번지 이전일 충청남도 아산시 배방면 북수리 산 74번지 박광준 충청남도 아산시 배방면 북수리 산 74번지 최상영
(74) 대리인	충청남도 아산시 배방면 북수리 산 74번지 윤동열, 이선희

**심사청구 : 있음**

**(54) 회전 스토퍼를 구비한 리포머 다이**

**요약**

본 발명은 반도체 패키지의 리포머 다이에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 반도체 패키지를 리포밍 하기 위한 다이구조에 있어서, 상기 상,하부다이를 이용하여 리포밍하게 될 때 서로 높이가 다른 반도체 패키지에 적용할 수 있는 회전 스토퍼를 구비한 리포머 다이에 관한 것이다.

본 발명은, 반도체 패키지의 리드를 성형하기 위한 리포머 다이에 있어서, 상기 하부다이의 외측에 회전 스토퍼를 구비한 것을 특징으로 하는 회전 스토퍼를 구비한 리포머 다이를 제공한다.

따라서, 상기 전술한 바에 의하면, 소량 다품종에 적용할 수 있으며, 펀치 다이의 수명을 연장시키고 작업시간의 손실을 방지하므로써 생산성을 향상시킬 수 있는 이점(利點)이 있다.

**대표도**

**도3**

**명세서**

[발명의 명칭]

회전 스토퍼를 구비한 리포머 다이

[도면의 간단한 설명]

제3도는 본 발명의 반도체 패키지를 리포밍하기 위한 상하부 다이를 보여주는 개략도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

**(57) 청구의 범위**

**청구항 1**

반도체 패키지의 리드를 성형하기 위한 리포머 다이에 있어서, 상기 하부다이의 외측에 회전 스토퍼를 구비한 것을 특징으로 하는 회전 스토퍼를 구비한 리포머다이.

**청구항 2**

제1항에 있어서, 상기 회전 스토퍼는 높이가 서로 다르도록 단차가 형성된 것을 특징으로 하는 회전 스토퍼를 구비한 리포머 다이.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

**도면**

도면3

